

PCB垂直化学镀锡药水单面双面多层板FPC沉锡药水电路板化锡

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PCB垂直化学镀锡药水单面双面多层板FPC沉锡药水电路板化锡 |
| 公司名称 | 广州市安美斯科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇捷顺路9号1栋717房 |
| 联系电话 | 13610248346 |

产品详情

SF-20化学镀锡工艺的特点如下

- 1.镀锡层为光滑,平坦,致密无孔隙的银白色镀层,在3000到5000倍扫描电镜下看不到锡须和粗糙颗粒。
- 2.镀锡层的厚度通常在0.7~1.2um,在1年内可承受多次焊接(在N2或O2气中)。
- 3.镀锡层经150℃下烘烤4h,或经8d的潮湿试验(40e,相对湿度93%),或经三次回流(Reflow)后仍具有优良的钎焊性。
- 4.镀锡层硬度低(60~70),板的翘曲与扭曲比热风整平(250)大为降低,镀液对绿油的攻击性影响小。
- 5.镀液稳定,操作方便,可通过分析补充连续使用。
- 6.和刚挠结合的表面装饰。连续滚轮(对软板)生产线使用,可用单或双面印制板,多层板,挠性板
- 7.镀液不含CL,镀层不含重金属铅等,适于无铅焊锡,符合环保要求。

二：SF-20新工艺规范及流程

2.1 工艺流程

酸洗除油→水洗2次→微蚀→去离子水洗2次→中和处理→去离子水洗2次→浸锡→烘干